

1017008-6 ✓ 有效

AMPMODU | Modu Connector System

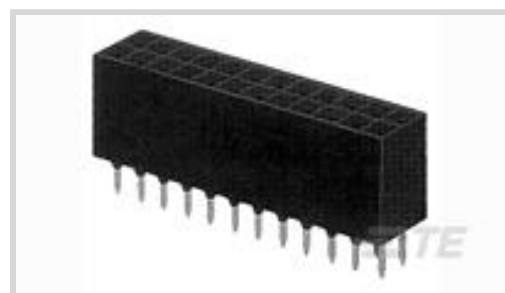
TE 内部编号 1017008-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	10
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μ m
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μ m[30 μ in]

端子形状和构造	短点
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	聚酯 PCT
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

堆叠高度	12.52 mm[.493 in]
连接器高度	8.12 mm[.32 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	45
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

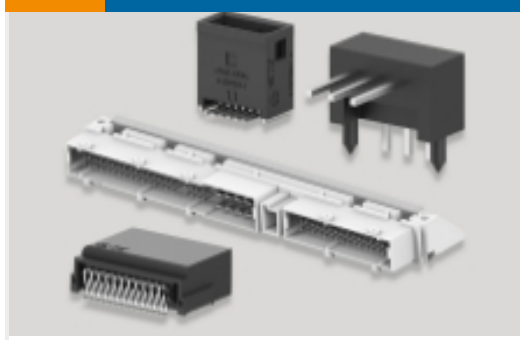
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



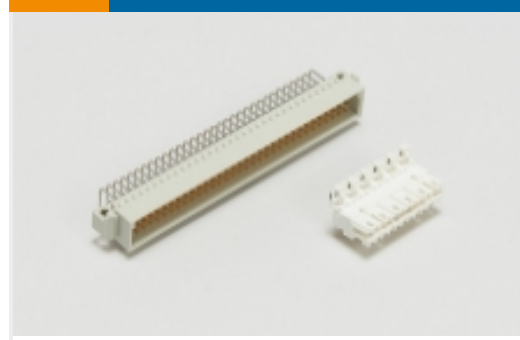
该系列中的其他产品 | Modu Connector System



PCB 板端连接器及母端(1244)



板对板跳线和分路(5)



标准边缘连接器(1)



汽车连接器护套(1)



汽车连接器盖帽(3)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(4)

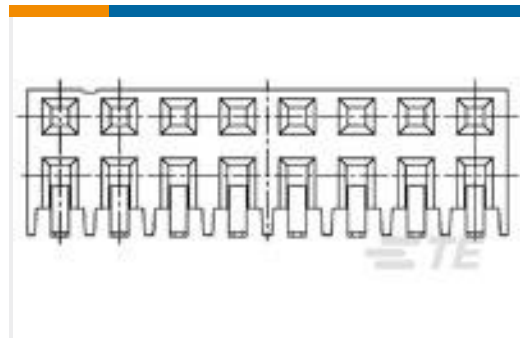
客户还购买了



TE 产品编号1-1734595-3
AMP HPI 1.0 mm Headers



TE 产品编号104885-1
MOD I RECP STMPD



TE 产品编号1-1734606-6
AMPMODU, 2mm Pitch, 16P, R/A
SMT, 8Au"



TE 产品编号2-1734795-2
RJ45, 8P8C, SHD, G/G LED, W/ Panel,
15u" Au"



TE 产品编号4-1734577-1
MODULAR JACK, RJ45, 8P8C, DIP
TYPE



TE 产品编号1622497-1
LR1 1% 4K32

文档

产品图纸

10 MODII VRT DR CE HI TEMP

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1017008-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

